

Low Noise GaAsFET(MM34, CK24, CK34 Package)	KMR-CEF-0063	1/1
	2015年 11月 6日	
	中央電子工業株式会社 電子デバイス事業部 Chuo Denshi Kogyo Co., Ltd Electronic Devices Division	

部分加熱方式のはんだ付け推奨条件
Recommended Soldering Conditions of Partial Heating

部分加熱方式のはんだ付け推奨条件を下記に示します。
The following is recommended soldering conditions of partial heating.

・ 最高温度（端子部温度）
Maximum Temperature (Pin Temperature)

: 350℃以下
: 350℃ or below

・ 時間（デバイスの一辺あたり）
Time(per side of the device)

: 3sec 以内
: 3s or less

・ ロジン系フラックスの塩素含有量
Maximum Chlorine Content of Rosin Flux

: 0.2%（wt.）以下
: 0.2%（wt.） or less

【注意事項】
【Precaution】

1、半田コテは、温度調整可能なものをご使用ください。
Use temperature adjustable soldering iron
必要以上に温度を上げますとデバイスの劣化を生じさせる可能性があります。
Unnecessary heat increase may cause deterioration of device.

2、作業時には、リード端子部根本およびモールド樹脂には半田コテが触れないように
ご注意ください。
Keep soldering iron away from base of lead pin and molding compound during work.

3、半田コテは、絶縁抵抗1MΩ以上で接地されているものを使用するか、もしくは
半田コテ先を1MΩ以上で接地することを推奨します。
Soldering iron condition with over 1MΩ resistance grounded or the soldering iron tip over 1MΩ grounded is recommended.

4、手付け実装の際は、人が介在する工程が増えるため、静電気によるデバイス損傷を
招く恐れがありますので、静電気対策を施すようにお願いします。
Electrostatic countermeasure is required during hand soldering. Avoid as much as possible materials that become easily charged electrically, and use instead conductive materials.